# The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Greate new Work

View: INPADOC | Jump to:

**₽**Title: JP11268824A2: CHIP TRANSFERRING DEVICE

JP Japan **P**Country:

> ହ Kind: A2 Document Laid open to Public inspection i (See also: JP3446598B2)

**PInventor: MIYAMOTO MASAYUKI**;

**P**Assignee: **MURATA MFG CO LTD** 

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: **1999-10-05** / 1998-03-23

> **P**Application JP1998000095457

Number:

**VIPC** Code: B65G 47//86; B65G 47//08; B65G 47//14; H05K 13//02;

Priority Number: 1998-03-23 JP1998000095457

> PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chip transferring PAbstract:

device capable of performing transfer at high speed, having a simple and small-sized drive mechanism, and having a little

generation of vibration.

SOLUTION: A transfer disc 1 is so arranged as to be inclined in relation to a horizontal surface, and it has transfer grooves 11 on the upper surface and cavities 12 on the outer peripheral surface. Chips C are dropped into the transfer grooves 11 and aligned in the specified direction with the rotation of the transfer disc 1, and one chip C is held by the cavity 12 by the action of gravity. A conveying disc 2 is provided with cavities 21 for receiving the chips C from the transfer disc 1 at equal pitches on the outer periphery, and air suction holes for sucking and holding the chips C in receiving the chips C from the transfer disc 1 are provided on respective cavities 21. The transfer disc 1 and the conveying disc 2 are continuously driven in synchronism with each other so that both cavities 12, 21

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

**VINPADOC** None Get Now: Family Legal Status Report

Legal Status:

may face to each other.

영Family: Show 15 known family members

DERABS G1999-496256



# BEST AVAILABLE COPY

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平11-268824

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

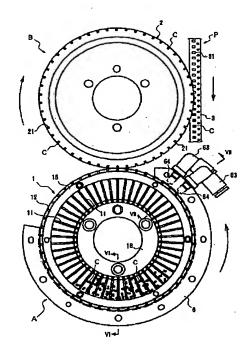
(51) Int.Cl.6	識別記号	FI
B65G 47	/86	B 6 5 G 47/86 G
47	/08	47/08 D
. 47	/14 1 0 2	47/14 1 0 2 B
H05K 13	/02	H 0 5 K 13/02 F
		審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 8 頁)
(21)出顧番号	特顏平10-95457	(71) 出願人 000006231 株式会社村田製作所
(ac) Hight E	W+2104:/1009) 2 H02H	京都府長岡京市天神二丁目26番10号
(22)出顧日	平成10年(1998) 3月23日	(72)発明者 宮本 昌幸
		京都府長岡京市天神2丁目28番10号 株式
		会社村田製作所内
		(74)代理人 弁理士 筒井 秀隆

## (54) 【発明の名称】 チップ部品の移載装置

## (57)【要約】

【課題】高速な移載が可能で、駆動機構を簡素でかつ小型にできるとともに、振動の発生の少ないチップ部品の移載装置を提供する。

【解決手段】振込円板1は水平面に対して傾斜するように配置され、その上面に振込溝11を有し、振込溝11の外周端部にキャビティ12を有する。振込円板1の回転に伴ってチップ部品Cを振込溝11に落ち込みませて所定の向きに整列させ、重力の作用によって1個のチップ部品をキャビティ12で保持する。搬送円板2はその外周部に振込円板1からチップ部品Cを受け取るためのキャビティ21を等ビッチ間隔で有し、各キャビティ21には振込円板1からチップ部品Cを受け取る際に吸着保持するエアー吸引穴22を有する。振込円板1と搬送円板2は、双方のキャビティ12,21が対向するように、同期をとって連続駆動される。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】チップ部品を1個ずつ収納保持するための キャビティを外周部に等ピッチ間隔で設けた移載側搬送 四板と、

チップ部品を1個ずつ受け取るためのキャビティを等じ ッチ間隔で設けた被移載側搬送媒体と、

移載側搬送円板と被移載側搬送媒体との最接近位置にお いて、移載側搬送円板のキャピティと被移載側搬送媒体 のキャビティとが対向するように、移載側搬送円板と被 段と、を備えたととを特徴とするチップ部品の移載装

【請求項2】上記移載側搬送円板は、上面が水平面に対 して傾斜するように配置され、その上面に内径側から外 径側へ延びてキャビティに通じるチップ部品を整列可能 な複数の振込溝を有する振込円板であり、

この振込円板の傾斜した最上部付近が被移載側搬送媒体 と最接近することを特徴とする請求項1に記載のチップ 部品の移載装置。

【請求項3】上記移載側搬送円板のキャビティは、チッ 20 ブ部品を移載側搬送円板の外周面より外方へ突出した状 態で保持することを特徴とする請求項1または2に記載 のチップ部品の移載装置。

【請求項4】上記被移載側搬送媒体は、キャビティを外 周部に等ピッチ間隔で設けた回転円板であることを特徴 とする請求項1ないし3のいずれかに記載のチップ部品 の移戴装置。

【請求項5】上記被移載側搬送媒体は、上面にキャビテ ィを等ピッチ間隔で設けた連続搬送体であることを特徴 とする請求項1ないし3のいずれかに記載のチップ部品 30 提供する。 の移載装置。

【請求項6】上記被移載側搬送媒体の各キャビティに、 チップ部品を吸引保持するためのエアー吸引通路を設け たことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載 のチップ部品の移載装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はチップ型電子部品の ようなチップ部品を1個ずつ分離された形態で一方の搬 送媒体から他方の搬送媒体へ乗り移らせる移載装置に関 40 するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、チップ部品をバーツフィーダから ロータの外周部に設けた凹部に乗り移らせ、チップ部品 を凹部に保持しながら間欠回転させることで測定などを 行なった後、ロータからキャリヤテープに乗り移らせて 装填するようにした分離搬送装置が、例えば特開平7-157071号公報に開示されている。

【0003】この種の分離搬送装置の場合、供給部であ るパーツフィーダはそれ自体が回転しないので、ロータ 50

にチップ部品を供給する際にロータを一旦停止させる必 要がある。そのため、ロータはステップ(間欠)回転す る必要がある。同様に、キャリヤテープも間欠駆動させ る必要がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、ステップ回 転を必要とするロータを用いると、移載速度を上げるに しても限度があり、2000個/分以上の高速移載を行 なうことが困難であった。また、1ピッチ回転する度に 移載側搬送媒体とを同期をとって連続駆動させる駆動手 10 駆動機構にロータの慣性力が作用するため、駆動機構と して堅牢でかつ大型のものが要求され、しかもロータが 停止する度に振動が発生するという問題があった。特 に、複数の測定を行なうために大型のロータを使用した 場合には、上記問題が一層顕著となる。

> 【0005】そとで、本発明の目的は、従来に比べてよ り髙速な移載が可能で、駆動機構を簡素でかつ小型にで きるとともに、振動の発生の少ないチップ部品の移載装 置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明は、チップ部品を1個ずつ収納保持するため のキャビティを外周部に等ピッチ間隔で設けた移載側搬 送円板と、チップ部品を1個ずつ受け取るためのキャビ ティを等ピッチ間隔で設けた被移載側搬送媒体と、移載 側搬送円板と被移載側搬送媒体との最接近位置におい て、移載側搬送円板のキャビティと被移載側搬送媒体の、 キャビティとが対向するように、移載側搬送円板と被移 載側搬送媒体とを同期をとって連続駆動させる駆動手段 と、を備えたことを特徴とするチップ部品の移載装置を

【0007】移載側搬送円板のキャビティに保持された チップ部品は、移載側搬送円板と被移載側搬送媒体との 最接近位置において、移載側搬送円板のキャビティと被 移載側搬送媒体のキャビティとが対向するように同期を とって連続駆動されているので、両者のキャビティ間に は相対速度が殆どなく、スムーズに乗り移る。特に本発 明では、移載側搬送円板と被移載側搬送媒体は間欠駆動 ではなく、連続駆動されるので、高速移載が可能となる とともに、振動の発生を抑制できる。また、駆動機構が 間欠駆動に比べて簡素となり、小型化が可能である。な お、チップ部品を乗り移らせるために、移載側搬送円板 からエアー噴射してもよいし、被移載側搬送媒体からエ アー吸引してもよい。また、重力を利用して乗り移らせ るようにしてもよい。

[0008]請求項2のように、移載側搬送円板が、上 面が水平面に対して傾斜するように配置され、その上面 に内径側から外径側へ延びてキャビティに通じるチップ 部品を整列可能な複数の振込溝を有する振込円板である 場合には、この振込円板の傾斜した最上部付近が被移載 側搬送媒体と最接近するように構成するのが望ましい。

すなわち、振込円板上に多数のチップ部品をばらばらの 状態で投入すると、振込円板の上面の傾斜によってチッ プ部品は下方へ集まる。振込円板の回転に伴ってチップ 部品の一部が振込溝に落ち込むとともに、所定の向きに 整列される。直方体形状のチップ部品の場合、振込溝の 幅をチップ部品の短辺より大きく、かつ長辺より小さく 設定すれば、振込溝でチップ部品を縦列方向に一例に整 列させることができる。振込溝は振込円板の上面に内径 側から外径側へ連続的に形成されているので、チップ部 品が振込溝に落ち込む確率が高くなる。振込溝に落ち込 10 んだチップ部品は、重力によって振込溝の外周端部へ滑 り、キャビティに入り込む。振込溝が上方へ回転する と、振込溝内のチップ部品は重力により下方(中心方 向) へ滑り、キャビティに保持されたチップ部品のみが 残ることになる。このようにして、1個ずつ分離された チップ部品を被移載側搬送媒体のキャビティに乗り移ら せることで、従来のパーツフィーダからロータへの乗り 移りに比べて格段に移載効率を向上させることができ る。

【0009】請求項3のように、移載側搬送円板のキャビティは、チップ部品を移載側搬送円板の外周面より外方へ突出した状態で保持するように構成するのが望ましい。この場合には、移載側搬送円板のキャビティから被移載側搬送媒体のキャビティへの乗り移りの際、チップ部品が両方のキャビティに跨がった状態をつくることができ、乗り移りがよりスムーズになる。

【0010】請求項4のように、被移載側搬送媒体がキャビティを外周部に等ピッチ間隔で設けた回転円板である場合には、移載側搬送円板のキャビティと被移載側搬送媒体のキャビティとを最接近位置で対向させた際、互 30いの周速度を同一とすることで、ギヤの噛み合いのように極めて円滑なチップ部品の乗り移りを可能とすることができる。

【0011】請求項5のように、被移載側搬送媒体が上面にキャビティを等ピッチ間隔で設けた連続搬送体である場合には、ラックとピニオンとの関係のように、移載側搬送円板から連続搬送体への円滑な乗り移りが可能である。連続搬送体としては、キャリヤテープや搬送ベルトなどが考えられる。

【0012】請求項6のように、被移載側搬送媒体の各キャビティにチップ部品を吸引保持するためのエアー吸引通路を設けた場合には、移載側搬送円板のキャビティから被移載側搬送媒体のキャビティへの乗り移りがより確実になり、乗り移りの際にチップ部品が脱落するといった不具合を解消できる。また、乗り移り後も、チップ部品をキャビティに安定に保持して搬送できる。

#### [0013]

【発明の実施の形態】図1~図10は本発明にかかるチ まで放射状に延びる多数本の振込溝11が形成されてキップ部品の移載装置の一例を示す。この実施例では、チ り、各振込溝11の幅および深さはチップ部品Cの短辺ップ部品として、図11に示すように、高さおよび幅が 50 H、Wより大きく、長辺Lより小さく設定されている。

それぞれH、W(但し、H≒W)で、長さがL(L> H、L>W)の直方体形状のチップ状電子部品Cが用い られる。とのチップ部品Cの長さ方向の両端には電極C a、Cbが形成されている。

【0014】 この移載装置は、図1、図2に示すように供給部Aと、搬送部Bと、パッケージ部Pとで構成されている。供給部Aには移載側搬送円板である振込円板1が設けられ、搬送部Bには被移載側搬送媒体である搬送円板(ターンテーブル)2が設けられ、パッケージ部Pにはキャリヤテーブ3が配置されている。供給部Aではランダムに投入されたチップ部品Cを1個ずつ分離して整列させ、搬送部Bでは供給部Aからチップ部品Cを1個ずつ分離して受け取り、搬送過程で測定や外観検査などの工程を行う。そして、良品のチップ部品Cのみをパッケージ部Pでキャリヤテーブ3に装填する。不良品のチップ部品Cは搬送部Bから図示しない不良品取出部へ排出される。

【0015】振込円板1および搬送円板2は共に、斜めに設置されたテーブル4の上に、それぞれベース41,42を介して回転自在に支持されている。テーブル4は、図1に示すように床に設置されたフレーム43上にターンバックルなどの調整手段44によって傾斜角度を調整可能に支持されている。

【0016】供給部Aは、図3に示すように、ベース41の中心部に挿通された駆動軸50と、駆動軸50を連続駆動するモータ51と、ベース41の上面に固定され、振込円板1の外周部の一部を取り囲む外ガイド6などを備えており、振込円板1は駆動軸50の先端部に連結され、ベース41の上面を摺動する。また、搬送部Bも、供給部Aと同様に、ベース42の中心部に挿通された駆動軸52と、駆動軸52を連続駆動するモータ53とを備えており、搬送円板2は駆動軸52の先端部に連結され、ベース42の上面を摺動する。

【0017】この実施例では、図2に矢印で示すように 振込円板1は反時計回り方向に駆動され、搬送円板2は 時計回り方向に駆動され、両円板1,2は互いに周速度 が同一となるように、かつ最接近位置でキャビティ1 2,21同士が一直線に並ぶように同期をとって連続駆 動されている。また、キャリヤテーブ3は搬送円板2の 外周部近傍に沿って接線方向に連続駆動されており、こ のキャリヤテーブ3も搬送円板2に対して、周速度が同 一となるように、かつキャビティ21,31同士が対応 するように同期をとって連続駆動されている。

【0018】 ことで、供給部Aについて詳述する。振込円板1は、その上面が水平面に対して所定の傾斜角 $\theta$  (0°  $<\theta$  < 90°) をもって設置されている。振込円板1の上面には、図4に示すように、内径部から外周縁まで放射状に延びる多数本の振込溝11が形成されており、各振込溝11の幅および深さはチップ部品Cの短辺H、Wより大きく、長辺しより小さく設定されている。

そのため、振込円板1上に多数のチツブ部品Cを投入 し、振込円板1に回転運動を加えると、チツブ部品Cは 重力の作用により振込溝1に落ち込む。振込溝11にチ ップ部品Cが落ち込むととで、チップ部品Cを縦列方向 に一例に整列させることができる。

【0019】振込溝11の外周端部には、図5に示すよ うに、チップ部品Cを1個だけ保持できる段穴状のキャ ビティ12が設けられている。なお、この実施例では、 キャビティ12の半径方向の長さmはチップ部品Cの長 辺しより短いため、キャビティ12に収納されたチップ 10 部品Cの一部が振込円板1の外周面側に突出している。 キャビティ12と振込溝11との底面の段差nは、チッ プ部品Cの短辺の長さWより小さいので、下向き状態の 振込溝11に入った後続のチップ部品Cがキャビティ1 2方向へ移動しようとしても、キャビティ12内のチッ プ部品Cによって外径方向への移動が規制される(図6 参照)。キャビティ12の内周部にはエアー吸引口13 が形成されており、振込円板1が回転してキャビティ1 2が後述するエアー吹き出し口64と対応した時(図7 参照)、エアー吸引口13は負圧源14と接続される。 そのため、キャビティ12に収納されたチップ部品Cは キャビティ12の内周側に吸着保持され、後述するエア ー吹き出し口19からの分離エアーの吹き飛ばし力によ ってチップ部品Cがキャビティ12から外れるのを防止 できる。振込円板1の外周部上面には、凹段部15がリ ング状に形成されている(図5参照)。

【0020】振込円板1の上面外周部には、振込溝11 に整列したチップ部品Cのみを振込円板1の外周方向に 移動可能とするゲート口17を形成するガイドリング1 込溝11の内径側端部には内リング18が固定されてい る。そのため、振込円板1の上面には、内リング18と ガイドリング16との間で、多数のチップ部品Cを収納 するための環状の収納空間が形成される。

【0021】上記内リング18には、放射方向を向く複 数のエアー吹き出し口19(図6参照)が等間隔で形成 されており、下向き位置にあるエアー吹き出し口19か **らエアーが吹き出され、振込溝11内で滑らずに停滞し** ているチップ部品Cを下方向(外径方向)に滑らせるき っかけを与えている。

【0022】上記ガイドリング16は、次のような作用 効果を有する。すなわち、回転運動を行う振込円板1上 のチップ部品Cに対して、ベース2に固定された外ガイ ド6のチップ部品Cに接する面は、相対スピードを持つ ことになる。振込円板 1 上に設けられた振込溝 1 1 に整 列されていないチップ部品Cが直接外ガイド6に接する 構造であると、チップ部品Cが外ガイド6に接したと き、そのチップ部品Cはその時の状態(姿勢)によりラ ンダムな方向から外力を受けることとなる。振込円板 1 の回転数を高く設定するときや微小チップ部品を扱うと 50 一吹き出し口64を設けることが有効である。

きには、上記外力がチップ部品Cが自重により受ける作 用に比べ非常に大きなものとなり、チップ部品Cの品質 上無視できないものとなる。そこで、チップ部品Cに対 するダメージを少なくすることを目的に、振込円板1に 一体回転するガイドリング16を固定したものである。 【0023】また、ガイドリング16の役割としては、 上記のほかに、振込溝11内に整列したチップ部品Cの みを振込円板1の外周部へ姿勢を乱さずに移送させるゲ ート口17を形成する機能がある。例えば、チップ部品 Cが振込溝11内で起立状態のままキャビティ12方向 へ滑ろうとすることがあるが、このようなチップ部品C はゲート口17の内縁で規制される。そのため、振込溝 11内に整列したチップ部品が外ガイド6に接する姿勢 は一定で、かつチップ部品Cの両側面が振込溝11の側 面にガイドされた状態となり、チップ部品Cに加わる外 力を最小限にできるとともに、チップ部品Cがキャビテ ィ12に不正常な向きで保持されることがない。

【0024】外ガイド6は、図8に示すように振込溝1 1を滑ったチップ部品Cが振込円板1からとぼれ落ちな いように、振込円板1の外周部、特に下側半分を含む領 20 域を取り囲むように適当な隙間61を設けて配置されて いる。この実施例では、振込円板1の約240°の範囲 を取り囲んでいる。外ガイド6の内周部には、振込円板 1の凹段部14に対応するテーパ状のガイド面62が形 成され、振込溝11の外周端部に到達したチップ部品C が円滑にキャビティ12に収納されるようガイドしてい る。なお、キャビティ12に収納されたチップ部品Cの 上に別のチップ部品Cが噛み込むのを防止するため、キ ャビティ12の底面とガイド面62との間隔Dは次の関 6が固定れている。また、振込円板1の上面であって振 30 係に設定されている。なお、Wはチップ部品Cの短辺の 長さである。W<D<2₩

> [0025] 円弧状の外ガイド6の上端部付近には、図 **2に示すようにチップ部品Cの1個分離を助けるための** エアーを噴出するノズル63が接続されている。この実 施例では2個のノズル63が接続されている。ノズル6 3の先端は、図7に示すように内径方向を向くエアー吹 き出し口64と接続されており、このエアー吹き出し口 64から噴射されたエアーにより、キャビティ12内の チップ部品Cを除く振込溝11内のチップ部品Cが内径 方向(下方)に付勢される。そのため、重力のみでは下 方へ滑らなかったチップ部品Cを強制的に下方へ滑ら せ、キャビティ12内のチップ部品Cのみを確実に1個 分離することができる。特に、振込円板1を髙速回転さ せると、振込溝11内のチップ部品Cに作用する遠心力 が大きくなるため、重力のみで内径方向へチップ部品C を戻すのが難しくなるが、上記のように分離エアーを吹 き付けることにより、確実に1個分離でき、髙速回転に 対応できる。なお、エアーによる1個分離機能の信頼性 を上げるためには、実施例のように周方向に複数のエア

[0026]上記のほか、分離エアーには以下の機能を持たせてある。

①振込円板1にチップ部品Cを振込む時、キャビティ1 2に完全に収納されなかったチップ部品Cを振込円板1 内に吹き戻す機能。

②振込溝 1 1 に振り込まれずに、振込円板 1 の表面にのったまま、振込円板 1 の回転運動により振込円板 1 の上部に移送されてきたチップ部品 C のかきおとし機能。 C の機能を効果的にするために、ガイドリング 1 6 と振込円板 1 との間にチップ部品 C より小さな隙間を設けるの 10 がよい。

【0027】次に、上記構成よりなるチップ部品供給部 Aの作動について説明する。まず、回転している振込円 板1の上面、特に内リング18とガイドリング16とで 囲まれた収納空間に多数のチップ部品Cを投入する。 このとき、振込円板1の上面は傾斜しているので、重力に よりチップ部品Cは振込円板1の下部に溜まり、その一部が振込溝11に落ち込んで整列される。振込溝11に 落ち込んだチップ部品Cは重力により下方へ滑り、先端の1個のチップ部品Cのみがキャピティ12に収納され 20る。なお、振込円板1の回転による複拌効果と姿勢変化 とにより、最初は振込溝11に落ち込むようになる。

【0028】チップ部品Cが落ち込んだ振込溝11が上方へ回転すると、重力によってキャビティ12内のチップ部品Cのみを残し、他のチップ部品Cは振込溝11に沿って下方へ滑る。振込円板1の傾斜角のによっては下方へ滑らないチップ部品Cもあり得るが、そのチップ部品Cはエアー吹き出し口64から吹き出された分離エアーによって振込円板1上へ吹き戻され、キャビティ12内のチップ部品Cが1個だけ分離される。なお、キャビティ12内のチップ部品Cはエアー吸引口13によって吸着保持されるので、分離エアーによってキャビティ12から脱落するのを防止できる。

【0029】振込円板1の回転にともなって、キャビティ12に1個ずつ分離保持されたチップ部品Cは振込円板1の上部へ運ばれ、取出位置つまり外ガイド6が欠如した部分でチップ部品Cは露出する。ここで、チップ部品Cはキャビティ12から搬送部Bの搬送円板2へと乗り移り、次の工程を行なう。

【0030】次に、搬送部Bについて説明する。搬送部Bでは、上述のように例えば測定や外観検査などの各種工程が行なわれる。搬送円板2は、外周部に多数のキャビティ21を等ピッチ間隔で設けたものであり、図9に示すように、キャビティ21の内周側にはエアー吸引穴22が形成され、図示しない負圧源と接続されている。この実施例では、キャビティ21の半径方向の長さRは、チップ部品Cの長辺しと略等しく設定されている。また、キャビティ21の外側開口部には拡開状のテーバ部23が形成されており、後述するように振込円板1か50

ら搬送円板2へのチップ部品Cの乗り移り動作を円滑に している。

【0031】ととで、振込円板1から搬送円板2へのチ ップ部品Cの乗り移り動作を図10にしたがって説明す る。図10の(a)は振込円板1と搬送円板2との最接 近点(移載点)より5°手前の状態を示す。チップ部品 Cは振込円板1のキャビティ12から一部が外径方向に 突出した状態で保持され、このチップ部品Cの突出部 は、テーパ部23によって搬送円板2と干渉せずにキャ ビティ21内に挿入される。なお、この付近まで回転し た時点で、振込円板1のキャビティ12に対するエアー 吸引を停止し、同時に搬送円板2のキャビティ21への エアー吸引を行なう。図10の(b)は振込円板1と搬 送円板2との最接近点より1°手前の状態を示す。チッ プ部品Cの突出部はテーバ部23を越えて搬送円板2の キャビティ21内にさらに深く挿入された状態にある。 そして、チップ部品Cがキャビティ21の両側壁によっ てガイドされ、一定の向きに補正される。図10の

(c) は振込円板1と搬送円板2との最接近点(0°) の状態を示す。この時、エアー吸引穴22からのエアー吸引力により、チップ部品Cは振込円板1のキャビティ12から搬送円板2のキャビティ21へ吸い込まれ、スムーズに乗り移る。なお、移載信頼性を高めるために、搬送円板2からのエアー吸引力のリークを少なくすることを目的として、移載点(0°)付近の上部にカバーを設けてもよい。

【0032】次に、パッケージ部Pについて説明する。 この実施例のキャリヤテープ3は、チップ部品Cをテー ピングするためのものであり、その上面にキャリヤ31 が等ピッチ間隔で形成されている。搬送円板2によって 所定位置まで回転したチップ部品Cは、パッケージ部P のキャリヤテープ3に乗り移るとともに、キャピティ3 1に1個ずつ装填される。この乗り移し動作としては、 例えば搬送円板2の外周部下面に沿ってキャリヤテープ 3を移動させ、搬送円板2のキャビティ21とキャリヤ テープ3のキャビティ31とが上下に対応した時点で、 キャビティ21のエアー吸引を停止することにより、チ ップ部品Cを重力によりキャリヤテープ3のキャビティ 31に落下させて装填する方法などがある。この場合 も、搬送円板2およびキャリヤテープ3を同一周速度 で、かつ双方のキャビティ21,31が上下に対応する ように同期させて連続駆動すればよい。

【0033】なお、搬送円板2からキャリヤテープ3へのチップ部品Cの乗り移り動作は、上記のような重力を利用する方法に限るものではなく、エアー吸引やエアー噴射などを利用してもよい。また、キャリヤテープ3は搬送円板2の下面に沿って移動するものに限らない。

【0034】上記のように、多数の振込溝11を有する 振込円板1を用いることにより、供給能力は非常に高く なる。例えば、振込円板1に50本の振込溝11を設 け、振込円板1を60回/分で連続回転させた場合、その供給能力は3000個/分にもなり、従来のパーツフィーダに比べて格段に高性能な供給部Aを実現できる。しかも、供給部Aから搬送部Bへの受渡し動作、および搬送部Bからパッケージ部Pへの受渡し動作も極めて円滑に行なえるので、上記供給能力を低下させずに測定や検査、パッケージを行なうことができる。

【0035】上記実施例では、移載側搬送円板を振込円 板1とし、被移載側搬送媒体を搬送円板2としたが、図 12のように移載側搬送円板および被移載側搬送媒体を 10 共に搬送円板2としてもよい。この場合、図13のよう に双方の搬送円板2のキャビティ21の半径方向の長さ Rをチップ部品Cの長さLより短くすれば、一方の搬送 円板2から他方の搬送円板2ヘチップ部品Cが乗り移る 際の移動距離が少なくて済み、移載信頼性が向上すると いう効果がある。なお、この場合も、双方の搬送円板2 のキャビティ21にエアー吸引穴22を設けてもよい。 【0036】本発明は上記実施例の構造に限定されるも のではないととは勿論である。例えば、上記実施例で は、直方体形状のチップ部品について説明したが、立方 20 体形状、円柱形状、円板形状など他の形状のチップ部品 でもよい。したがって、チップ部品の形状に合わせて振 込溝やキャビティを形状を変更すればよい。また、図1 ~図10の実施例では、供給部Aとして振込円板1を用 いたが、振込円板1に代えて、連続回転する搬送円板の キャビティにチップ部品Cを1個ずつ投入できるような 構造の供給機構を用いてもよい。したがって、供給部A を振込円板1を用いたものに限定するものではない。

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に 30 よれば、移載側搬送円板と被移載側搬送媒体との最接近位置において、移載側搬送円板のキャビティと被移載側搬送媒体のキャビティとが対向するように、移載側搬送円板と被移載側搬送媒体とを同期をとって連続駆動させるようにしたので、ステップ回転によって移載を行なう\*

\* 方式に比べて高速移載が可能となるとともに、振動の発生を抑制できる。また、駆動機構は円板を一定速度で連続回転させればよいので、駆動機構には円板の慣性力が 殆ど作用せず、間欠駆動に比べて構造が簡素となるとと もに小型化が可能である。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる移載装置の一例の全体正面図である。

【図2】図1のII方向矢視図である。

【図3】図1の供給部の断面図である。

【図4】振込円板の斜視図である。

【図5】振込溝の外周端部の拡大斜視図である。

【図6】図2のVI-VI線拡大断面図である。

【図7】図2のVII -VII 線拡大断面図である。

【図8】図3の一部の拡大断面図である。

【図9】搬送円板の一部の拡大図である。

【図10】振込円板から搬送円板へのチップ部品の乗り 移り動作を示す説明図である。

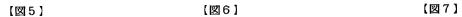
【図11】チップ部品の一例の斜視図である。

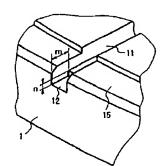
【図12】本発明にかかる移載装置の他の例の平面図で ある。

【図13】図12における搬送円板の一部の拡大図であ ろ

### 【符号の説明】

С	チップ部品
1	振込円板
1 1	振込溝
1 2	キャビティ
2	搬送円板
2 1	キャビティ
2 2	エアー吸引穴
3	キャリヤテープ
3 1	キャビティ
51, 53	モータ





[0037]

